

## Manz 亞智科技攜手 XTPL 開發半導體超精細點膠設備解決方案

XTPL 借助 Manz 亞智科技在亞洲的業務與研發能力，為客戶提供從研發到量產設備導入的完整技術解決方案

【台灣桃園 – 2026 年 2 月 24 日】專注於半導體面板級封裝設備研發與製造的 Manz 亞智科技，與 XTPL ( WSE:XTP ) 宣布建立策略合作夥伴關係。XTPL 開發的半導體超精細點膠設備，可高度精準控制功能性奈米材料的沉積，線寬範圍從數十微米到小於 1 微米，已通過顯示器產業的量產驗證，目前亦拓展至半導體先進封裝製程等領域。雙方將攜手推動這項技術在半導體先進封裝領域的應用及商業化發展，為客戶提供從研發到量產設備導入的完整技術解決方案。此次合作不僅擴展了 Manz 亞智科技產品組合，也進一步強化了公司在全球先進封裝製程市場的技术布局。

根據合作計畫，XTPL 將在 Manz 亞智科技桃園半導體創新與研發中心建置一套 Delta Printing System，打造在地化製程開發與驗證平台。此研發設備將協助客戶導入超精細點膠技術，並提供從研發到量產導入的完整技術轉移及商業化路徑，有效縮短新技術落地時間，提升研發效率。

此次合作結合 XTPL 超精細點膠技術與 Manz 亞智科技在半導體製程設備及系統整合的專業能力。雙方將聚焦與第三方客戶共同合作，評估具市場潛力的應用機會，推動實質商業成果，打造彈性且高效的製造解決方案，滿足客戶多元化需求。

Manz 亞智科技總經理林峻生表示：「Manz 亞智科技的既有技術可支援導電與非導電材料的精準沉積，滿足 2D 與 2.5D 架構製程需求；導入 XTPL 超精細點膠技術後，更進一步延伸至 3D 架構應用。此次合作不僅擴展了 Manz 亞智科技的產品組合，也鞏固了我們在全球半導體先進封裝製程設備市場的創新地位。我們將加速下一代封裝技術的市場落地，回應對高密度、高整合度與高可靠度的需求，打造更具彈性與可擴展性的製造解決方案，協助客戶降低導入風險並縮短驗證至量產的時程。」

XTPL 執行長 Filip Granek 補充：「我們非常高興能與在亞洲半導體產業具有關鍵地位的 Manz 亞智科技建立合作。XTPL 的奈米級超精細點膠技術將與 Manz 的先進封裝製程、自動化與系統整合解決方案緊密結合，共同協力加速創新技術在先進封裝市場的落地與規模化應用。這項合作將推動超精細點膠技術創造實質商業機會，並開啟下一代半導體製程的新可能性。」



▲ Manz 亞智科技攜手 XTPL 開發半導體超精細點膠設備解決方案

#### 關於 Manz 亞智科技

Manz 亞智科技是半導體面板級封裝生產設備製造與整合解決方案領導商，擁有前沿核心技術涵蓋化學濕製程、電鍍、噴墨印刷、自動化設備與軟體整合，應用於生產製造先進封裝（高密度 PLP / FOPLP）及 IC 基板（玻璃載板及有機載板），支援客戶從研發到大規模量產。核心業務聚焦於生產設備整合方案、高精密設備代工製造及代理銷售，我們協助客戶加快產品上市速度、提升良率，並在快速發展的半導體產業中保持競爭力。

#### 關於 XTPL

XTPL S.A. ( WSE:XTP ) 專注於開發與商業化其專有的超精細點膠 ( UPD ) 技術，可精準沉積功能性奈米材料，線寬範圍從小於 1 微米至超過 50 微米。該技術適用於先進電子市場，包括半導體、顯示器、重佈線層 ( RDL )、多晶片模組及高階 PCB 應用，並已通過顯示器產業高量產驗證。XTPL 自 2019 年起於華沙證券交易所主板上市，並自 2020 年起於德國法蘭克福公開市場掛牌交易。更多資訊請見：[www.xtpl.com](http://www.xtpl.com)

媒體聯絡人：

黃筑青 Yvonne Huang

Manz 亞智科技 | 行銷公關處長

電話：03-452-9811 ext: 3399

電子郵件：[yvonne.huang@manz.com](mailto:yvonne.huang@manz.com)